

第一介質 10 必須經發酵處理，並且經高溫熱處理，如此可將細菌藉由高溫而將其消滅，所以第一介質 10 乾淨、無臭味。因此於栽培物栽種在第一介質 10 時，可避免栽培物受細菌侵害而枯萎。

第一介質 10 之壓縮比率可為 1.1~15:1，依照第一介質 10 之椰纖 30 與椰肉 20 的比例，而進行壓縮。若是椰纖 30 較多，則第一介質 10 透氣性佳，因此空隙也很多；所以壓縮比率較高。若是椰肉 20 較多，則第一介質 10 保水率佳，因此空隙也較少；所以壓縮比率較低。而壓縮後猶如第一圖所示，壓縮成一磚型之立方體。

第一介質亦可不經壓縮，只需將第一介質以乾燥方式處理，使第一介質之水份低於 50%。於使用本發明之有機栽培介質時，首先將第一介質 10 設置於一容器，然後加入適當水分於第一介質 10，待第一介質 10 吸水膨脹後，即可將栽培物設置於第一介質 10。

請參閱第三 A 圖與三 B 圖，其係為本發明另一較佳實施例之有機栽培介質之立體圖與局部放大圖；如圖所示，此實施例不同於上一再於此實施例之第一介質 10 係包含椰肉 20、椰纖 30 與椰殼 40，藉由添加椰殼 40，更可增加有機栽培介質之透氣性。

請參閱第四圖，其係為本發明另一較佳實施例之有機栽培介質之立體圖；如圖所示，本發明之有機栽培介質亦可包含一第二介質 50，第二介質 50 亦經乾燥及壓縮處理。而第二介質 50 不同於第一介質 10 在於第二介質係包含以切塊處理之一椰殼 40；椰殼 40 體積較大，因此空隙較多。所以第二介質之壓縮比率可為 1.1~15:1；也因此更可讓有機栽培介質於運送時更節省空間，讓有機栽培介質的運送量提升，更節省運輸成本。

請參閱第五 A 圖與第五 B 圖，其係為本發明較佳實施例之栽種結構之立體圖與剖視圖；如圖所示，本發明之栽種結構包含一介質 60 與一容器 70，該介質 60 經由乾燥並壓縮，而且介質 60 設置於容器 70 內。該容器 70 可為一袋體，當使用者使用栽種結構時，僅需打開容器 70 並加水或其他培養液於其中，乾燥壓縮之介質吸水後會迅速膨脹，即可栽種栽培物。不需如